

株主メモ

事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定時株主総会	10月
基準日	7月31日
	上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
配当金支払株主確定日	期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所プライム市場
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ (https://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ (https://www.tr.mufg.jp/daikou/) でも承っております。

(ご注意)

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

サムコナウのご紹介

「研究者の皆様と産業界の橋渡し」をコンセプトにした広報誌サムコナウ (samco NOW) では、最新のトピックスをはじめ、ユーザーのインタビューなど、当社の最新情報を掲載しております。当社をよりご理解いただくためにもぜひアクセスしてください。



<https://www.samco.co.jp/company/samconow/>

samco®



samco®
サムコ 株式会社

証券コード 6387

第47期中間期の売上高・営業利益・当期純利益は過去最高となりました。 最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、 省エネ、脱炭素社会の実現に貢献しております。

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社第47期中間期（2025年8月1日～2026年1月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

第47期中間期の事業環境、経営成績

当中間会計期間における世界経済は、各国の貿易政策の変更に伴う景気減速懸念がある一方で、AIをはじめとするテクノロジー関連分野への投資拡大や、概ね緩和的な財政・金融政策に支えられ、緩やかながらも堅調に推移いたしました。

半導体等電子部品業界におきましては、AI関連需要が引き続き拡大するとともに、スマートフォン等の需要も緩やかな回復基調となりました。当社が関連する化合物半導体市場におきましても、AI関連投資が進み、特にデータセンター向けの需要が拡大しております。当社の製造装置は、データセンターにおける通信の高速化および低消費電力化に寄与する光デバイスの製造工程に使用されており、旺盛な需要を受け受注高は急拡大し、売上高も伸びました。

このような状況の下、当中間会計期間における業績は、売上高が4,587百万円（前年同期比11.3%増）、営業利益は1,028百万円（前年同期比3.8%増）、経常利益は1,073百万円（前年同期比6.1%増）、中間純利益は751百万円（前年同期比5.1%増）となりました。

今後の取り組み、下期の見通し

第47期中間期につきましては、売上高と営業利益は当初計画を若干下回ったものの経常利益と中間純利益は上回る着地となりました。通期目標である売上高10,200百万円、当期純利益1,720百万円の達成に向け、営業活動や製品開発に全社で取り組んでまいります。2025年9月に竣工した「先端技術開発棟」の稼働により、化合物半導体分野における最先



代表取締役会長 兼 CEO 辻 理

端の技術開発体制を強化し、グローバルニッチ市場のリーディングカンパニーを目指しております。

なお、配当につきましては、通期での実施を予定しておりますので、株主の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

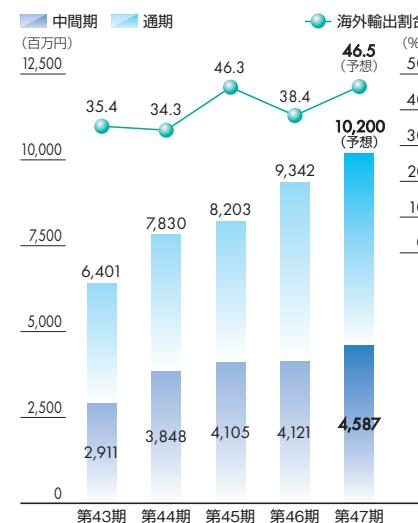
株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、成長力と収益力の向上を図り、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



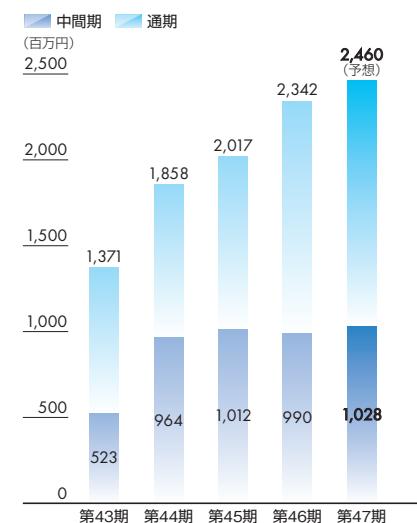
代表取締役社長 兼 COO 川邊 史

決算ハイライト

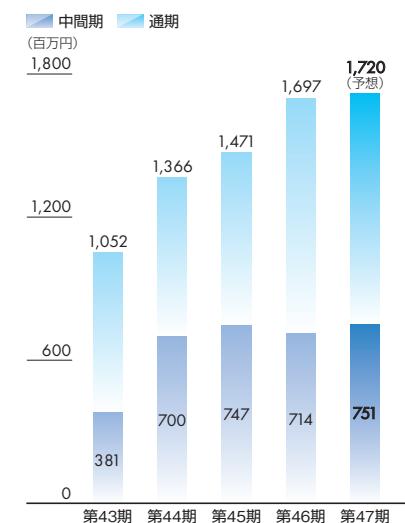
■ 売上高・海外輸出割合



■ 営業利益



■ 中間(当期)純利益



製品販売

2反応室ALD装置「AD-8002LPC」の販売を開始

当社は、2反応室構成を採用した原子層堆積（ALD）装置「AD-8002LPC」の販売を開始しました。近年、半導体デバイスの微細化および三次元構造化の進展に伴い、数nm以下の膜厚制御や高アスペクト比構造への均一成膜が求められています。特に、界面品質や膜厚制御がデバイス特性に直結する領域では、原子層レベルで成膜を制御できるALD技術の重要性が高まっています。本製品は国内外で豊富な納入実績を有するALD装置「AD-800LP」の反応室を採用しています。独立した2つの反応室を備えることで材料切替や異なるプロセス条件への対応を効率化し、研究開発用途から生産用まで、幅広いニーズに対応可能です。



海外事業

TOWAとサムコ、インド・ニューデリーにて「Kyoto Day」を盛況のうちに開催

TOWA株式会社とサムコ株式会社は2025年9月1日（月）、インド・ニューデリーにて共同技術セミナー「Kyoto Day」を盛況のうちに開催いたしました。本イベントは国際展示会「SEMICON India」に先立ち実施され、両社の顧客や関係者を中心に50名以上が参加しました。会場は活気にあふれ、半導体業界における日本の先端技術とインド市場の強い関心が交差する場となりました。



海外事業

インド工科大学デリー校と学術交流に関するMOUを締結

2025年9月1日、代表取締役会長の辻はインド・ニューデリーで開催された招待講演を行った後、IIT Delhi学長のランガン・バナジー教授、エネルギー理工学部長のバムシ・クリシュナ・コマララ教授と調印式を行いました。今回のMOU締結により、両組織の連携を加速してまいります。

- ・本MOUに基づき、両組織は以下の分野で協力を進めてまいります。
- ・研究および教育プログラムに関する情報交換
- ・技術セミナー、会議、ワークショップの共同開催
- ・研究プロジェクトやトレーニングプログラムの共同提案および実施
- ・技術者、博士課程修了者（ポスドク）および学生の相互交流

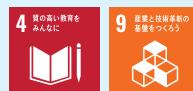
今回のMOU締結により、半導体およびエネルギー関連技術をはじめとした分野での共同研究・人材交流を通じて、産学連携をさらに強化するものです。これにより、当社はグローバルな技術革新を支えるとともに、次世代の人材育成にも貢献してまいります。



社会貢献

会長の辻、京都工芸繊維大学より名誉博士号を授与

当社の創業者であり、会長の辻 理が、国立大学法人京都工芸繊維大学より名誉博士号を授与されました。本称号は、辻が長年にわたり薄膜技術分野の発展を牽引するとともに、同大学において継続的な講義を行うなど、産業界の知見を次世代へ還元し、教育・研究の振興に多大なる貢献を果たした功績が認められたものです。当社は、技術革新と高度人材の育成において、産業連携が極めて重要であると認識しております。今回の栄誉を励みとし、今後も大学・研究機関との強固なパートナーシップを通じて、科学技術と産業の発展に貢献してまいります。



展示会

「SEMICON Japan 2025」に出展

2025年12月17日から19日までの3日間、半導体製造装置の先端技術が集結する日本最大の展示会「SEMICON Japan 2025」が開催されました。延べ来場者数は12万1千人（前年比1.7割増）となり、DX時代を支える半導体と周辺産業への関心の高さが伺えました。当社ブースでは、ALE（原子層加工）装置、クライオICPエッチング装置、枚葉式Aqua Plasma®装置などを最新のプロセスデータとともに展示しました。さらに、カセット反応室2室ALD装置「AD-8002LPC」、リモートプラズマ方式に対応したオープンロードALD装置「AD-10P」、φ8”対応のSi犠牲層除去XeF₂エッチャー「VPE-220NL」といった新製品を紹介し、連日多くの来場者で賑わいました。



展示会

世界各国のSEMICONショーに出展

当社では重点課題の1つに「海外事業の拡大」を掲げており、海外での展示会にも積極的に出展をしております。当期は9月のSEMICON India（インド）、SEMICON Taiwan（台湾）、10月のSEMICON West（アメリカ）、11月のSEMICON Europa（ドイツ）、12月のSEMICON Japan（日本）などに出展し、最先端技術の紹介や製品発表などを実施しております。



SEMICON Westの当社ブース



■ 会社概要

商号 サムコ株式会社 (英文: SAMCO INC.)
 設立 1979年 (昭和54年) 9月
 事業内容 半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
 資本金 1,663,687,288円
 従業員数 190名
 本社 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地
 TEL (075) 621-7841 FAX (075) 621-0936
 国内拠点 本社 (京都)、東日本営業部 (東京)、東海支店 (愛知)、つくば営業所 (茨城)
 海外拠点 米国 (カリフォルニア・ニュージャージー)、台湾、シンガポール、中国 (上海・北京)、マレーシア
 研究拠点 本社研究開発センター (京都)、オプトフィルムス研究所 (米国)

■ 役員

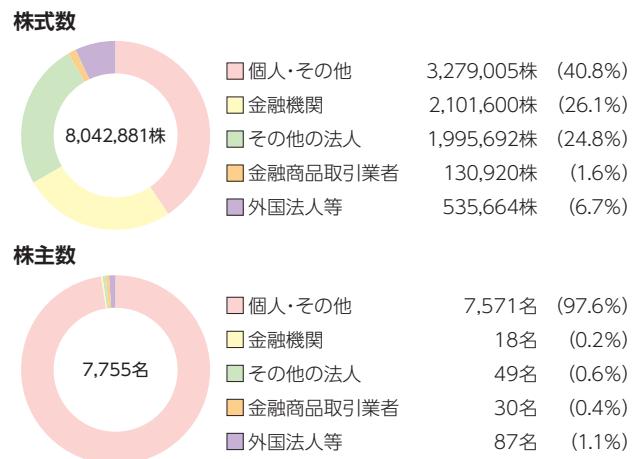
代表取締役会長兼CEO 辻 理
 代表取締役社長兼COO 川 邊 史
 取締役専務執行役員 山下 晴彦
 取締役執行役員 宮本 省三
 佐藤 清志
 社外取締役 村上 正紀
 高須 秀視
 藤田 静雄
 柳本 依子
 常勤監査役 辻村 茂
 社外監査役 西尾 方宏
 木村 学
 執行役員 松出 和男
 江崎 裕二
 ヘンリー・チャン
 上杉 能章
 山本 潤
 八田 博文
 山本 仁志

■ 株式の状況

発行可能株式総数 14,400,000株
 発行済株式の総数 8,042,881株
 株主数 7,755名
 大株主の状況

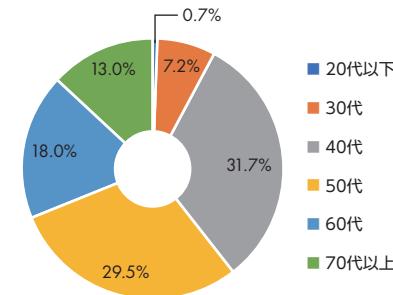
株主名	持株数(株)	持株比率(%)
(一財)サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	916,100	11.4
辻 理	861,697	10.7
サムコエンジニアリング(株)	850,282	10.6
(株)日本カストディ銀行(信託口)	377,200	4.7
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行(投信口)	150,200	1.9
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	129,800	1.6
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
立田 利明	103,099	1.3

■ 所有者別株式分布状況

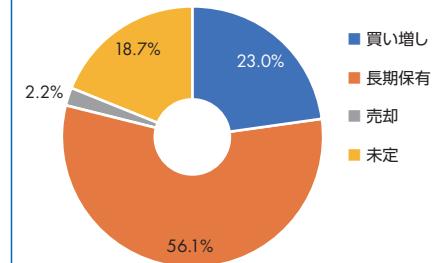


第46期年次報告書にてご案内した株主アンケートには、多くの株主様からご回答をいただき、厚くお礼を申し上げます。株主様から寄せられたご意見の一部をご報告いたします。いただきました貴重なご意見を今後の事業活動に活かしてまいります。

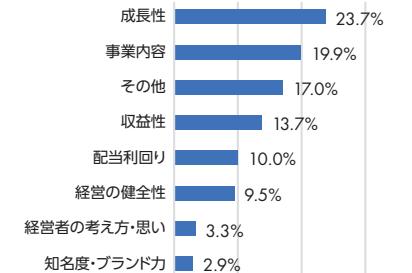
あなたの年齢をお知らせください。



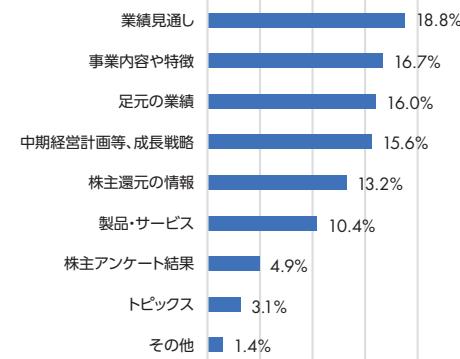
当社の株式に対してどのような方針ですか？



当社に投資する決め手となったポイントは何か？ (複数回答可)



今後、年次報告書への記載を希望または充実してほしい情報は何か？ (複数回答可)



ご意見のご紹介 (一部)

- ▶ 株主向け説明会・見学会を開催してほしい。
- ▶ 株式通信については事業内容などが写真付きで説明されていて良くわかる。
- ▶ いい人材の確保が会社の成長につながると考えます。人材に対する投資をお願いします。
- ▶ 化合物半導体の需要が増えて、御社の製品が多く受注されることを願っております。
- ▶ サムコ株式会社とは？というページが良かった。〇〇会社とは？という情報は大事なはずだが、ほとんどの会社の株主通信には無いので、素晴らしいと思います。
- ▶ 安定成長と株主還元を期待します。
- ▶ プレゼント付きアンケートは今後も継続してほしいです。
- ▶ ますます世の中に役立つ会社になっていってください。
- ▶ 事業内容はもちろん、自己資本比率が高く、信頼・期待できると感じています。